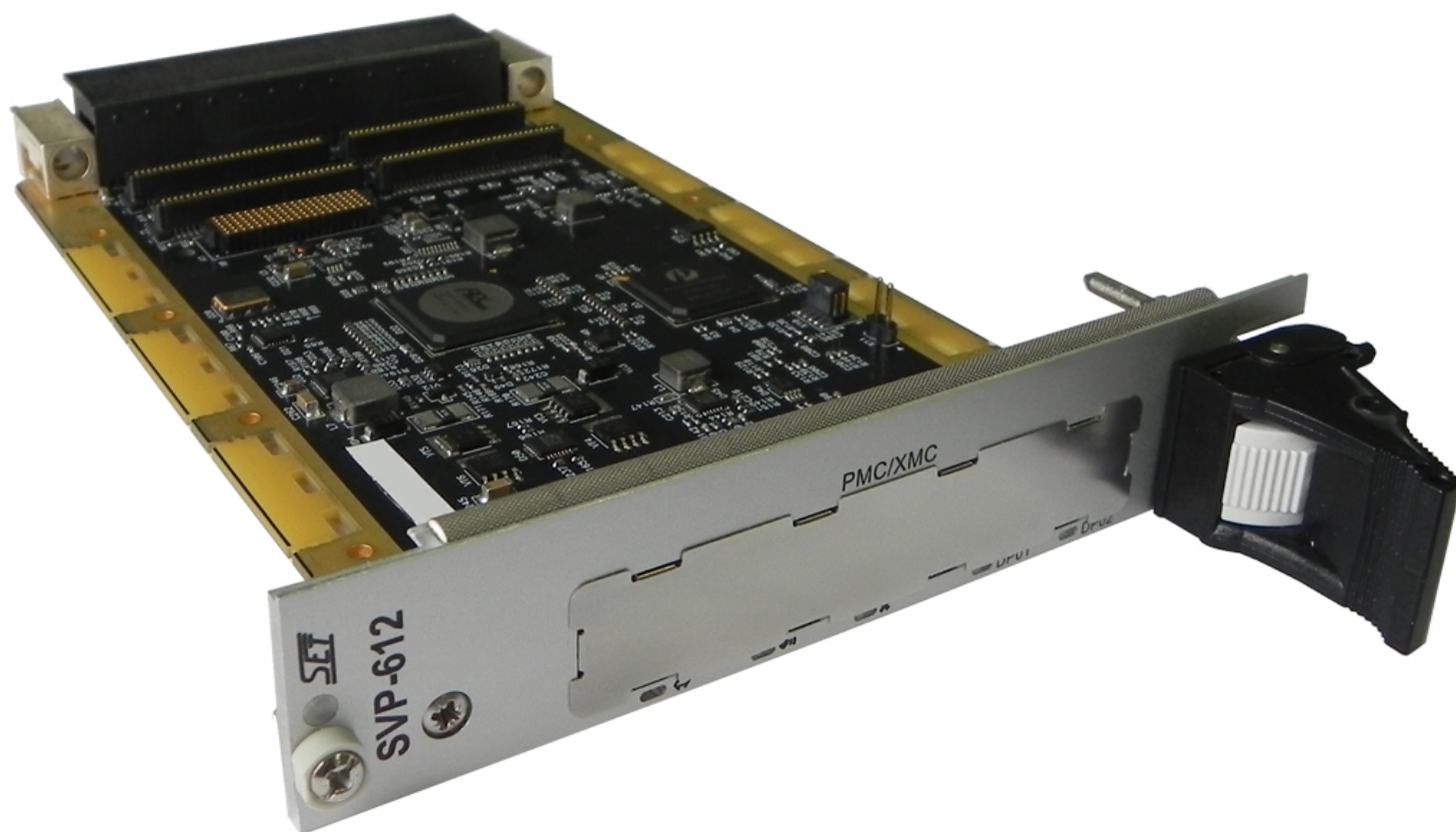


# SVP-612

 Несущий модуль для submodule PMC/XMC  
форм-фактора VPX 3U

## Основные особенности

- Установка одного submodule PMC или XMC
- Подключение по шине PCIe 2.0 x4
- Модуль форм-фактора VPX 3U, соответствующий стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 46.4-2012, ANSI/VITA 46.9-2010, ANSI/VITA 48.2-2010 (кондуктивное охлаждение) и ANSI/VITA 65-2010 (R2012)
- Профиль слота модуля: MOD3-PER-2F-16.3.1-3
- Вывод сигналов (P2w1-P64s) с разъёма PMC I/O (J4) на разъём VPX P2
- Поддержка интерфейсов PCI/PCI-X 64 бит/100 МГц для PMC
- Интегрированная интеллектуальная система контроля и управления IPMI v. 1.5

## Обзор модуля

### Особенности

Модуль SVP-612 — несущая плата для субмодулей PMC/XMC, конструктива VPX в форм-факторе 3U с гибкими коммутационными возможностями и с широким диапазоном рабочих температур. Конструктивное исполнение SVP-612 соответствует стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard, ANSI/VITA 46.4 VPX: PCI Express Signal Mapping, ANSI/VITA 46.9 VPX: PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules, ANSI/VITA 48.2 VPX REDI: Mechanical Specifications for Microcomputers Using Conduction Cooling Applied on VPX и ANSI/VITA 65 System Standard и позволяет встраивать в систему широкую гамму готовых субмодулей PMC единичной ширины.

Набор интерфейсов соответствует профилю MOD3-PER-2F-16.3.1-3.

Система IPMI v. 1.5 позволяет осуществлять удаленный мониторинг температур и напряжений питания, что снижает вероятность сбоя системы или выхода из строя оборудования.

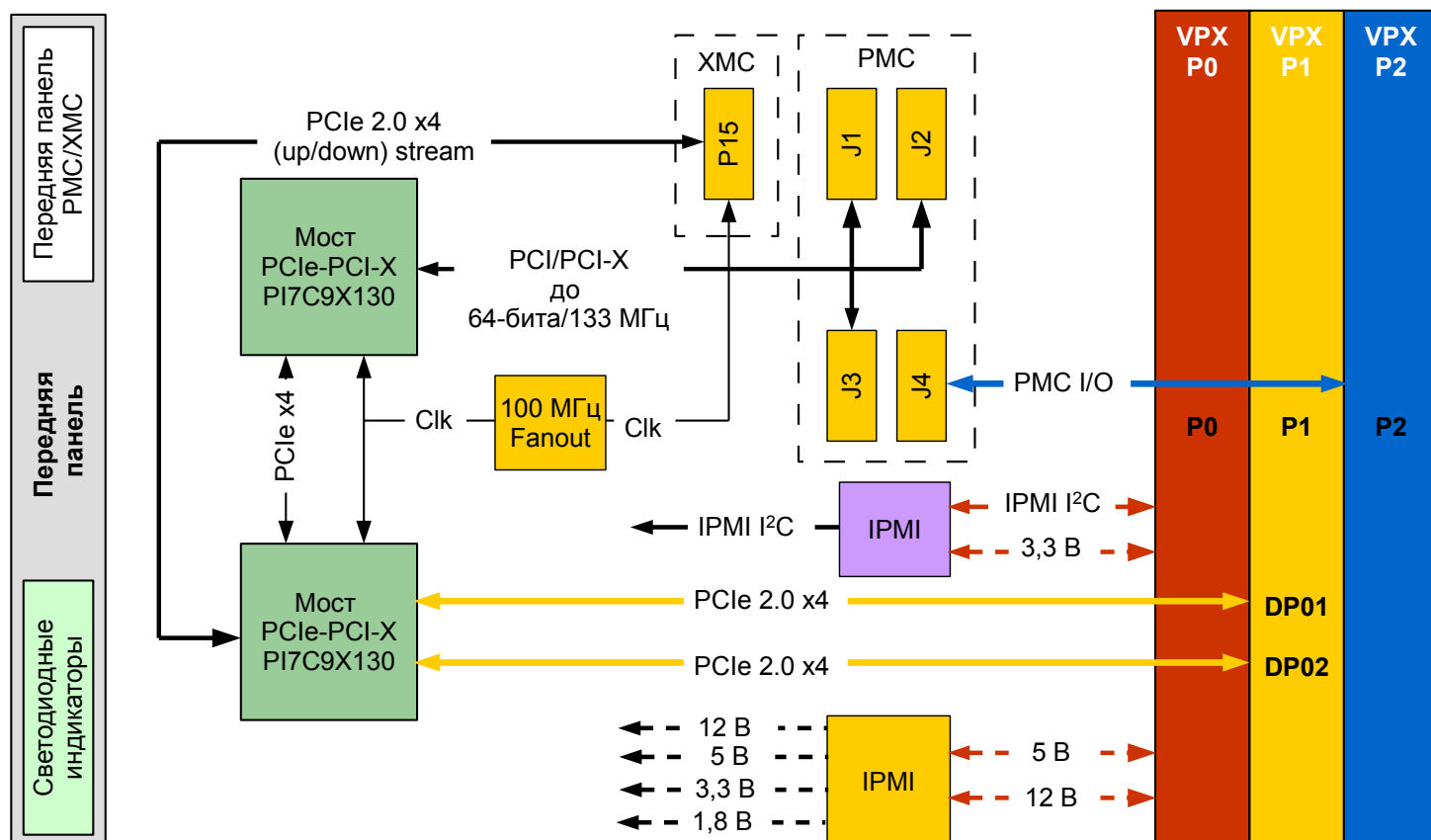
### Совместимость с операционными системами (ОС)

Контроллеры интерфейсов и интегрированные устройства процессора не требуют написания специального программного обеспечения, все поставляемые драйверы совместимы с большинством ОС. Стандартная поставка модуля обеспечивает драйверную поддержку в следующих ОС: Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2, QNX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0, ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01), Astra Linux Special Edition 1.3/1.4/1.5, Защищённая ОС «Заря», MCBC 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3 и Linux (с версией ядра 3.2.0 и выше).

### Области применения

Любые системы, построенные на оборудовании стандартов VPX 3U, где требуется расширение функциональных возможностей за счет дополнительных PMC или XMC субмодулей.

## Функциональная блок-схема



## Технические характеристики

### Интерфейсные контроллеры

Мост PCI Express-PCI Pericom PI7C9X130: преобразование PCI Express x4 в PCI-X 64 бит/133 МГц для PMC субмодуля

Коммутатор PEX8619 2x PCI Express x4 на:

- PCI Express x4 на мост PCI Express-PCI-X Pericom PI7C9X130;
- PCI Express x4 на разъём P15, для XMC субмодуля.

### Субмодули

Поддержка установки субмодуля PMC: 1 × PMC: шина PCI-X 64 бит/133 МГц (индивидуально для каждого субмодуля)

Поддержка установки субмодуля XMC: 1 × XMC: шина PCI Express 2.0 x4

### Система мониторинга и управления IPMI

Автоматическое отключение питания при возникновении серьезных сбоев на модуле

Мониторинг температур и напряжений питания модуля

Ведение журнала учета отказов блоков системы

Возможность удаленного контроля и управления модулем

Возможность «горячего» обновления и восстановления программного обеспечения IPMI без нарушения работы модуля

Информационная шина на разъеме VPX P0 для управления и мониторинга (IPMB-L)

Поддержка «горячей замены» (Hot Swap)

### Соответствие стандартам

ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard

ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector

ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard

ANSI/VITA 48.2-2010 Mechanical Specifications for Microcomputers Using REDI Conduction Cooling Applied to VITA VPX (кондуктивное охлаждение)

ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard  
Профиль модуля: MOD3-PER-2F-16.3.1-3

IPMI v. 1.5 с поддержкой служебных функций

### Поддержка ОС

Microsoft Windows 7/8.1/10, Embedded Standard 7/8.1, Server 2008 R2 SP1/2012/2012 R2

QNX Neutrino RTOS 6.5.0/6.6.0

ЗОСРВ «Нейтрино» (КПДА.10964-01)

Astra Linux Special Edition 1.3/1.4/1.5

Защищённая ОС «Заря»

МСВС 3.0 ФЛИР.80001-16 изм. №3

Linux (с версией ядра 3.2.0 и выше)  
(Поддержка других ОС уточняется отдельно)

### Разъёмы VPX

Разъём P0

- 1 × IPMI I<sup>2</sup>C.

Разъём P1

- 2 × PCI Express x4 (DP01–02, пластины 1–8).

Разъём P2

- Сигналы I/O субмодуля PMC I/O (P2w1-P64s).

### Энергопотребление

Потребляемая мощность несущего модуля не более 41 Вт (при установленном субмодуле)

Распределение потребляемой мощности по линиям питания:

- +12 В (VS1/VS2): до 2 А (24 Вт);
- +5 В (VS3): до 4 А (20 Вт);
- +3,3 В\_AUX до 0,1 А (0,33 Вт) (питание IPMI).

### Условия эксплуатации

Охлаждение: воздушное или кондуктивное

Диапазон рабочих температур: коммерческий (0...+50 °C) или промышленный (-40...+85 °C)

Температура хранения: -50...+85 °C

Влажность: 10–95 % без конденсата

Возможность нанесения влагозащитного покрытия для жёстких условий

### Размеры

Форм-фактор: VPX 3U

Размеры: 160 × 100 × 25,06 мм

## Информация для заказа

**I**

Исполнение (температурный диапазон)

**T0:** Коммерческое (0...+50 °С)**T1:** Индустриальное (-40...+85 °С)**II**

Покрытие

**CV0:** Без влагозащитного покрытия**CV1:** С влагозащитным покрытием**III**

Охлаждение

**CL0:** Воздушное**CL1:** КондуктивноеПример кода изделия: **SVP-612-T1-CV1-CL1****SVP-612** — Несущий модуль для submodule РМС/ХМС форм-фактора VPX 3UИсполнение (температурный диапазон): *Индустриальное (-40...+85 °С)*Покрытие: *С влагозащитным покрытием*Охлаждение: *Кондуктивное*

Возможны другие конфигурации модуля по индивидуальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в SET.

## Контактная информация



ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком»  
Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75  
Тел.: +7 (473) 272-71-01, факс.: +7 (473) 251-21-99  
[www.setdsp.ru](http://www.setdsp.ru)

Электронная почта:  
Отдел продаж: [sales@setdsp.ru](mailto:sales@setdsp.ru)

ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»  
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корп. 1, лит. М.  
Тел.: +7 (812) 406-99-95, +7 (812) 406-99-96  
[www.setdsp.ru](http://www.setdsp.ru)

Электронная почта:  
Отдел продаж: [sales.spb@setdsp.ru](mailto:sales.spb@setdsp.ru)

ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком». Все права защищены. © 1991–2018  
Документ DS-SVP-612 1.1 создан в ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб». Все права защищены. © 2018